

北京君正集成電路股份有限公司

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

股份代號: **3223** 主板

公開發售價

HK\$102.80

半導體產品及設備

回撥機制 B: 公開認購 10%份額 (無強制回撥)

背景/業務

君正股份是「存儲+計算+模擬」芯片提供商，我們的產品廣泛應用於汽車電子、工業醫療應用，以及 AIoT 及智能安防設備。君正股份經營模式為無晶圓廠模式，據此，君正股份聚焦芯片的研發與設計，同時與領先晶圓廠及半導體封測代工（「封測代工」）公司展開合作，以確保業務可擴展性。通過內生增長與戰略收購，君正股份成為一家擁有全面產品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，君正股份在全球範圍的關鍵市場佔據領先地位，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	4,530,926	4,212,626	4,741,008
其他（虧損）及收益	149,868	139,931	176,666
除稅前溢利	545,204	409,965	413,680
年度／期內溢利	515,724	364,198	375,331
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	26.93 港元		
2025 歷史市盈率	122x		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰海通		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

8 月 20 日 (四) 上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100-400 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 500-900 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	31,287,300 股 H 股
公開發售: 3,128,800 股 H 股	
配售: 28,158,500 股 H 股	
集資總額	\$3,216.3 百萬港元
集資淨額	\$ 3,141.2 百萬港元
市值	HK\$ 75,307.8 百萬港元
公開發售日	2026 年 8 月 17 日- 2026 年 8 月 20 日
公開發售結果	8 月 21 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	8 月 25 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 若君正股份未能妥善預測或應對不斷變化的市場環境，或未能及時研發並推出新產品或升級產品，君正股份吸引及留住客戶的能力可能會受損，競爭地位亦可能會受到不利影響。
2. 君正股份的業績受到採用我們產品的下游行業需求以及終端產品價格波動的影響。
3. 君正股份經營所處行業歷來具有週期性特徵，並已經歷平均售價下跌的低迷期。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|--------|
| 1. 將用於加強三條核心產品線（存儲芯片、計算芯片和模擬芯片）的技術創新和產品開發。 | 50.00% |
| 2. 將用於戰略投資及/或收購，以把握增長機遇。 | 25.00% |
| 3. 將用於擴展網絡並推廣產品。 | 15.00% |
| 4. 將用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營和一般公司支出。 | 10.00% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司